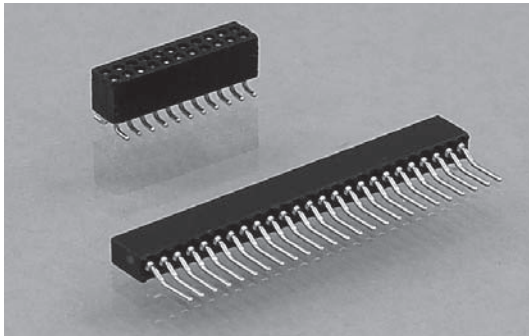


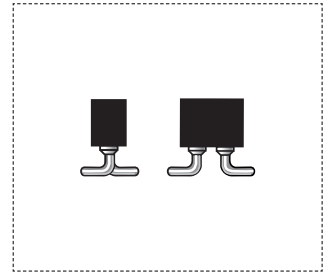
(寸法単位:mm)



SMD超ミニチュアPCBレセプタクル 表面実装用ハンダ付タイプ

仕様

適合ピン径: -001/-002シリーズ: $\varnothing 0.35 \sim 0.50\text{mm}$
 -051シリーズ: $\varnothing 0.38 \sim 0.50\text{mm}$
 挿抜力: 挿入力 0.5N typ./引抜力 0.2N typ.
 (研磨したスチールゲージを使用 $\varnothing 0.41\text{mm}$)
 機械的寿命: 500回(最低)
 定格電流: 1A 接触抵抗: 20m Ω (最大)
 耐電圧: 500Vrms(最低)
 SMDコプラナリティー: 0.1mm(最大)



適合ピンシリーズ
R850/R852/R854



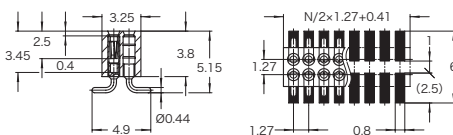
任意のピン数に
カット出来ません。

標準以外のピン数をご希望の場合はお問い合わせ下さい。

R853...30-001シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 2列 ピン数 4~100 標準ピン数 50, 100



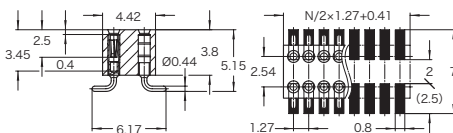
メッキ仕上げ		ピン数		
スリーブ	コンタクト	50ピン	100ピン	任意のピン数 [※]
純錫	0.75 μm 金	R853-83-050-30-001	R853-83-100-30-001	R853-83-xxx-30-001
純錫	金 フラッシュ	R853-87-050-30-001	R853-87-100-30-001	R853-87-xxx-30-001

■ ハーフピッチの表面実装ダブル・インライン・レセプタクルで、基板に対し垂直に実装されます ※xxxにピン数を入れて下さい。4~100ピン

R853...30-002シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 2列 ピン数 4~100 標準ピン数 100

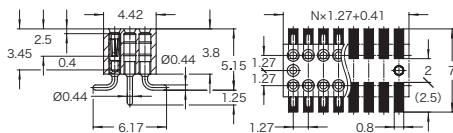


メッキ仕上げ		ピン数		
スリーブ	コンタクト	100ピン	—	任意のピン数 [※]
純錫	0.75 μm 金	R853-83-100-30-002	—	R853-83-xxx-30-002
純錫	金 フラッシュ	R853-87-100-30-002	—	R853-87-xxx-30-002

■ 2列の間隔が2.54mmのハーフピッチの表面実装ダブル・インライン・レセプタクルで、基板に対し垂直に実装されます ※xxxにピン数を入れて下さい。4~100ピン

R853...30-051シリーズ

表面実装 2列 ピン数 4~100 標準ピン数 100



メッキ仕上げ		ピン数		
スリーブ	コンタクト	—	100	任意のピン数 [※]
純錫	0.75 μm 金	—	R853-83-100-30-051	R853-83-xxx-30-051
純錫	金 フラッシュ	—	R853-87-100-30-051	R853-87-xxx-30-051

■ R853...30-002シリーズの両端に位置決めピンが付いているタイプです ※xxxにピン数を入れて下さい。4~100ピン



PCBコネクタ/レセプタクル一般仕様

以下の仕様は、PCBレセプタクル及びコネクタに適用の一般仕様です。追加および製品仕様のテクニカルデータについては個々のカタログページをご覧ください。

一般仕様

動作温度範囲	-55~+125°C
耐候性分類(IEC)	55/125/21
動作湿度範囲(域)	年平均75%
最大定格電圧	AC100Vrms/DC150V(2.54mmピッチ)

UL PRECI-DIP製品はUL(Underwriters Laboratories Inc.)認定品です。
UL規格「データ、信号、制御及び電力用途使用のコネクタ」にリストされています。File Nr. E174442

機械的特性

クリップ維持力	40N(最小、軸方向力適用では無変位)
コンタクト(スリーブ/クリップ)維持力	3.3N(最小) MIL-DTL-83734,pt4.6.4.2

電機的特性

隣接コンタクト間での絶縁抵抗値	10,000MΩ(最小、500Vacにて)				
隣接コンタクト間の静電容量	1pF(最大)				
隣接コンタクト間の沿面距離	3xx/4xx/7xxシリーズ 0.7mm	80xシリーズ 0.85/0.7mm	83xシリーズ 0.5mm	85xシリーズ 0.4/0.5mm	86xシリーズ 0.5mm

環境特性 ソケットは以下の環境試験において機械的/電気的に支障無く耐えることが出来ます。

乾熱試験	IEC 60512-11-9.11i/60068-2-2.Bb	温度125°C, 16時間
湿熱試験	IEC 60512-11-12.11m/60068-2-30.Db	温度25/55°C, 湿度90-100%RH, 1サイクル24時間
低温試験	IEC 60512-11-10.11j/60068-2-1.A	温度-55°C, 2時間
熱ショック試験	IEC 60512-11-4.11d/60068-2-14.Na	温度-55/125°C, 5サイクル30分
振動(正弦)試験*	IEC 60512-6-4.6d/60068-2-6.Fc	10~500Hz, 10g, 1オクターブ/分, 各軸方向10サイクル
衝撃試験*	IEC 60512-6-3.6c/60068-2-27.Ea	50g, 11ms, 3軸方向3衝撃
※上記二つの試験中に50ns以上のコンタクトの瞬断が無い事。		
ハンダ付性	J-STD-002A	Test A, 245°C, 5秒間, ハンダ SnAg3.8Cu0.7
ハンダ付耐熱性	J-STD-020C	260°C, 20秒
耐湿性	J-STD-020C	level 1
耐腐食性	1) 塩水噴霧試験	IEC 60068-2-11.Ka 48時間
	2) 二酸化硫黄ガス(SO2)試験	IEC 60068-2-42 Kc 25ppm SO ₂ , 25°C, 75%RHで96時間
	3) 硫化ガス(H2S)試験	IEC 60068-2-43 Kd 12ppm H ₂ S, 25°C, 75%RHで96時間

無ハンダ対応プレスフィット特性 プレスフィット特性はIEC60325 -5に対応して測定されています。

挿入力	90N(最大)@最小穴直径/65N typ.
引抜き力	30N(最小)@最大穴直径/50N typ.
引抜き力 3サイクル時	20N(最小)@最大ホール直径
PCBホール寸法	2mmピッチ 仕上げ穴: Ø0.7+0.09/-0.06mm, ドリル穴: Ø0.8±0.2mm
	2.54mmピッチ 仕上げ穴: Ø2+0.09/-0.06mm0, ドリル穴: Ø1.15±0.02mm
PCBホールメッキ	PCB表面処理 ホールメッキ
	錫 5-15µm錫(最小、25µm銅の上)
	銅 25µm(最小)
	金(ニッケル上) 0.05-0.2µm金(最小、25µm銅の上に2.5-5µmニッケル)

材質

シリーズ	右記以外	R830/R831/R832/R833	R831...64-001/R833...64-001/ R831...64-242/R833...64-245
インシュレーター	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、PCT-GF30FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR
スリーブ	CuZn36Pb3(C36000)	CuZn36Pb3(C36000)	CuDn4Pb4Zn4(C54400)
コンタクト		ベリリウム銅(C17200)	

